

請求の範囲

- [請求項1] 質量%で、Scを0.01～1%含有し、さらにY、La、Ce、Pr、Ndの少なくとも1種以上を合計で0.01～0.1%含有し、残部がAl及び不可避不純物からなることを特徴とするAlボンディングワイヤ。
- [請求項2] ワイヤ長手方向に垂直な断面における平均結晶粒径が0.1～50 μm であることを特徴とする請求項1に記載のAlボンディングワイヤ。
- [請求項3] ワイヤ長手方向に垂直な断面において、結晶<111>方位とワイヤ長手方向との角度差が15°以内である結晶の面積比率が30～90%であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のAlボンディングワイヤ。
- [請求項4] ビッカース硬度がHv20～40の範囲であることを特徴とする請求項1から請求項3までのいずれか1項に記載のAlボンディングワイヤ。
- [請求項5] ワイヤ直径が50～600 μm であることを特徴とする請求項1から請求項4までのいずれか1項に記載のAlボンディングワイヤ。